

深圳市景旺电子股份有限公司关于投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目
- 投资金额：268,895.50 万元
- 特别风险提示：项目实施过程中可能会面临市场风险、运营风险、政策风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

一、对外投资基本情况

（一）投资项目基本情况

为提升公司高端 PCB 的制造技术和能力，满足国际领先品牌客户对高端高质 PCB 的需求，提升公司的综合核心竞争实力，提升公司在技术、研发、产品等方面的优势，公司拟投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目”（以下简称“HDI 项目”或“本项目”）。本项目预计投资总额为 268,895.50 万元，项目资金来源为自筹。

（二）董事会审议情况

公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事发表了独立的同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

（四）项目批复情况

本项目已取得广东省环境保护厅出具的环评批复。项目涉及的其他政府部门备案事项正在办理中。

二、投资项目具体情况

（一）项目主要内容及建设期

1、投资内容及建设期

为提升公司高端 HDI 的制造能力，公司拟投资建设 268,895.50 万元建设年产 60 万平方米的高密度互连印刷电路板项目，建设内容包括新建厂房、宿舍、研发大楼及相关生产制造配套设施等。通过项目建设，新建高端 HDI（含 mSAP 技术）生产线，形成 60 万平方米的高密度互连印刷电路板生产能力。

项目规划建设期 4.5 年，于 2019 年第四季度开始建设，于 2024 年第一季度全部建成，于 2025 年达产。

2、实施地点及实施主体

本项目由公司的子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）实施，珠海景旺基本情况如下：

公司名称：景旺电子科技（珠海）有限公司

注册资本：人民币 1 亿元

成立日期：2017 年 8 月 21 日

主要经营范围：研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板，半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务，对外贸易进出口业务。（涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外）。

主要财务指标：根据珠海景旺 2018 年《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，珠海景旺经审计的总资产为人民币 99,042,555.23 元，净资产为人民币 98,999,458.96 元。

截至 2019 年 9 月 30 日，珠海景旺的总资产为人民币 100,925,903.37 元、

净资产为人民币 98,881,034.88 元（以上数据未经审计）。

3、总投资额及资金来源

本项目预计投资总额 268,895.50 万元，项目资金来源为自筹。

（二）主要产品及市场定位

随着 5G 商用的启动，智能终端产品的换机潮即将来临，智能终端产品的销量会急剧上升，销量将以较高速度增长。高通预测，到 2022 年全球 5G 智能手机累计出货量预计将超过 14 亿部，2025 年全球 5G 连接数预计达到 25 亿。

随着全球电子信息制造产业向中国转移，我国已经成为全球电子信息制造中心，智能手机产业和市场均位居全球首位。本次项目生产的产品定位为高端 HDI，与普通 HDI 产品制造厂商形成差异化竞争。本次项目生产的产品，符合智能终端市场对元器件“轻、薄、短、小”的要求，具有更高布线密度、更小更薄的外形尺寸、高可靠性的特点，专用于小容量空间的设计，面向新一代智能手机、平板电脑、可穿戴设备等高性能的消费电子终端市场，项目实施具备广阔的市场空间。

（三）项目投资效益预测

本项目建成达产后，预计可实现不含税年销售收入 277,200.00 万元，年税前利润总额 52,467.59 万元，项目投资回收期 8.61 年（税后）。

三、投资本项目对上市公司的影响

1、本项目建成后，可以使公司快速进入批量高端 HDI 领域，在增加公司营收规模的同时可提高公司高附加值产品的比重、丰富公司产品的种类、进一步夯实公司的技术能力，满足客户更多高端 HDI 产品需求，一站式满足客户多样化产品需求，提高客户粘性，提升公司品牌力和核心竞争力。

2、本项目致力于满足全球一流智能终端客户的高端 PCB 需求，项目全部达产后，将带动公司营业收入规模和利润规模的大幅增长。

四、风险提示

1、宏观经济波动带来的风险。PCB 是电子产品的关键电子互连件，其下游行业包括通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，而该等下游行业的发展与全球宏观经济形势息息相关。全

球宏观经济变化将对我国 PCB 行业产生重要影响。如未来全球经济增速放缓甚至迟滞、居民可支配收入减少，对高端消费电子产品需求将会减少，将直接导致 PCB 下游行业增速放缓甚至下滑，本行业市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况。

2、市场竞争风险。PCB 行业竞争格局较为分散，集中度较低，但日益呈现行业集中的趋势。本项目可能会因为产品市场竞争格局发生重大变化、市场供需实际情况与预测值发生偏离、项目产品市场竞争力发生重大变化等引发市场风险。如果公司不通过本项目的开展，未来不能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，将在市场竞争中落后。

3、毛利率下降的风险。公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、产品良率、产能利用率等多种因素的影响。本项目建设周期长、投资金额大，在建设期间，如果上述因素发生不利变化，将有可能导致公司毛利率下降，从而对公司盈利状况造成不利影响。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日